



First ST Wi-Fi 6 network coprocessor modules



意法半導體推出首款與高通合作之支援STM32的無線 IoT 模組

WiFi6 / 藍牙 5.3 / Thread ST67W611M1模組加速開發進度並提升設計靈活性，
以提供先進的消費和工業物聯網解決方案

【臺北訊，2024年12月17日】—服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出了與高通技術策略合作的首款產品，以簡化下一代工業和消費物聯網無線解決方案研發流程。此項合作旨在藉由意法半導體強大的STM32生態系統，以及高通技術領先的無線連接解決方案，提供無線物聯網模組。

第一款ST67W611M1模組包含一個Qualcomm® QCC743多協定連接系統晶片（SoC），其預載Wi-Fi6、已獲認證的Bluetooth 5.3和Thread組合協定，可以與任何一款STM32微控制器（MCU）或微處理器（MPU）輕鬆整合。該模組將支援Wi-Fi上的Matter協定，因應未來的無線連接，讓STM32產品組合能夠無縫與Matter生態系統連接。為協助系統整合，該模組還內含用於程式碼和資料儲存4MB快閃記憶體，以及一個40MHz晶振。此外，模組還配有一個整合式PCB天線或微型RF（uFL）外部天線連接器。

意法半導體微控制器、數位IC和射頻產品部（MDRF）總裁Remi El-Ouazzane表示，「我們的合作為使用STM32系列設計嵌入式系統的廣大開發者提供了多重優勢。現在，產品開發者可以輕鬆藉由高通極具影響力和使用廣泛的無線連接技術，搭配STM32開發生態系統強大的軟體、工具和功能，加速專案的進度」

高通技術連接、寬頻和網路業務部總經理Rahul Patel則表示，「我們的使命才剛開始，預計此一合作將會獲得更多成果，並創造更先進的邊緣處理應用，我們期待與意法半導體繼續合作，透過Wi-Fi、藍牙、AI、5G等技術為使用者帶來更多無與倫比的連接體驗。」

先進的硬體安全性內建硬體加密加速器，以及包括安全開機和安全除錯等功能，其達到PSA 1級認證保護。該模組是一個獨立的產品，根據強制性規範進行預先認證，使用者無需具備射頻設計專業知識即可著手研發。該模組在32腳位的LGA封裝內整合諸多功能，可直接安裝在電路板上，並可進行簡單而且低成本之最少兩層的PCB設計。

ST67W611M1利用STM32 生態系統，使用其包含4,000多款產品、功能強大的STM32Cube工具和軟體，以及促進邊緣人工智慧開發的軟硬體，其中包括近期推出的 STM32N6 MCU和ST Edge AI Suite軟體。STM32N6 MCU整合了意法半導體自研的神經網路處理器Neural-ART Accelerator，而ST Edge AI Suite還提供了AI Model Zoo模組庫以及STM32Cube.AI和 NanoEdge AI優化工具。

這些模組可快速、無縫地與任何STM32微控制器或STM32微處理器整合，在效能、價格和功耗則具備廣泛的彈性選擇。現有微控制器產品系列齊全，覆蓋低中高階應用，包括搭載Arm® Cortex®-M0+內核心之具成本和功耗考量的產品，還有高性能內核心微控制器，例如，搭載Cortex-M4和Cortex-A7的STM32MP1/2 MPU。

ST67W611M1樣片已經就緒，2025年第一季開始供貨給OEM廠，大眾市場供貨時間則為2025年第二季。

更多資訊，請瀏覽：www.st.com/st67w。

STM32 是意法半導體國際有限公司(STMicroelectronics International NV)或其相關公司在歐盟和／或其他地區之註冊和／或未註冊商標。而STM32亦已在美國專利商標局註冊。

本新聞稿中提及之高通和驍龍產品由高通技術和／或其子公司提供。高通和驍龍為高通的商標或註冊商標。

關於意法半導體

意法半導體匯聚超過 5 萬名半導體技術的創造者和製造者，掌握半導體供應鏈和先進的製造設備。做為一家整合元件製造商 (IDM)，意法半導體與逾 20 萬家客戶與數千個合作夥伴一起研發產品和解決方案，攜手建立生態系統，協助客戶因應挑戰和新機會，滿足世界對於永續發展之更高的需求。意法半導體的技術讓人們出行更智慧，電源和能源管理更高效，物聯網和連接技術的使用更廣泛。意法半導體致力於 2027 年達成碳中和（適用於範圍 1 和範圍 2，以及部分範圍 3）之目標。更多資訊，請瀏覽意法半導體官方網站：www.st.com。